

## PI 调整剂

### 产品简介

本品专门用于聚酰亚胺 (Polyimide) 树脂表面的处理, 具有以下特点:

- 1、本品对聚酰亚胺树脂有微蚀作用, 使化学铜层与基体有更可靠的结合力;
- 2、通过此工序处理, 可以增强聚酰亚胺树脂的清水能力;
- 3、除去钻孔留下的污物;
- 4、有利于胶体钯的吸附, 增加化学铜对树脂的覆盖能力;
- 5、对柔性多层板的内层有回蚀 (Etch back) 作用, 使内层与孔壁连接

### 建浴

纯水 50-80%  
T6001 20-50%

### 操作条件

温 度 40°C (30-50°C)  
时 间 5min (2-8min)  
摇 摆 机械摇摆  
加热器 不锈钢, 石英或铁氟龙  
过 滤 需要  
振 动 需要

### 槽液管理

#### 1. 操作法

1.1 每处理 100 平方米, 补充 T6001 4000ml;

控制项目	控制范围	最佳值	分析频率	添加量	备注
氢氧化钾	25-40g/L	视情况定	每班一次	/	/
强度	20-50%	视情况定	每班一次	/	/
Cu 离子	<2 g/L	/	每班一次	/	/

1.2 每升工作液处理的板达到 20m<sup>2</sup>，或铜离子浓度达到 2g/L 时，需要重新换缸。

1.3 每添加 40 ml/L T6001 可提高游离 KOH 5g/L，KOH 浓度可单独添加颗粒或片状氢氧化钾来提高。

1.4 用于软板生产工艺及材质各有不同，对 PI 调整剂的需求不尽相同，可根据要求进行调整浓度及其它参数。

### 注意事项

- 1.本品是一种碱性的混合溶液，有极强的腐蚀性，在空气中发烟；
- 2.如果不慎，接触到皮肤或衣服上，要立即用大量的清水清洗；
- 3.溶液的存放要避免阳光直接照射。要放置在阴冷的地方，不要与酸类物质一起堆放。